

8线数据选择器/多路复用器

SCL S110E - 1982年12月 - 修订2003年9月

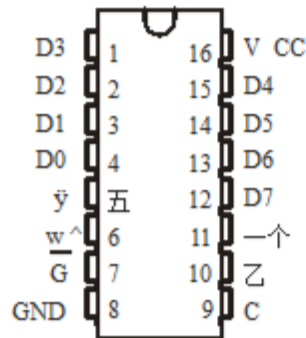
- D 宽工作电压范围2 V至6 V
- D 输出可驱动10个LSTTL负载
- D 低功耗, 最大 80 μ A I_{CC}
- D 典型 t_{pd} = 13 ns
- 在 ± 5 V时的 D ± 6 mA 输出驱动

- D 最大1 A的低输入电流
- D 8线到1线多路复用器可以执行

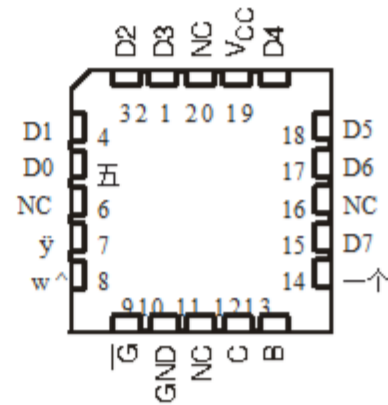
如:

- 布尔函数发生器
- 并行 - 串行转换器
- 数据源选择器

SN54HC151 ... J或W包装
SN74HC151 ... D, N, NS, 或PW包装
(顶视图)



SN54HC151 ... FK包装
(顶视图)



NC - 没有内部连接

描述/订购信息

这些数据选择器/多路复用器提供完整的二进制解码来选择八个数据源之一。频闪 (G) 输入必须处于低逻辑电平才能使能输入。选通端子的高电平强制W输出高和Y输出低。

订购信息

TA	包†		订购 零件号	TOP-SIDE 打标
-40℃至85℃	PDIP - N	25管	SN74HC151N	SN74HC151N
	SOIC - D	40管	SN74HC151D	HC151
		2500的卷轴	SN74HC151DR	
		250的卷轴	SN74HC151DT	
	SOP - NS	2000卷	SN74HC151NSR	HC151
	TSSOP - PW	90管	SN74HC151PW	HC151
		2000卷	SN74HC151PWR	
		250的卷轴	SN74HC151PWT	
-55℃至125℃	CDIP - J	25管	SNJ54HC151J	SNJ54HC151J
	CFP - W	150管	SNJ54HC151W	SNJ54HC151W
	LCCC - FK	55管	SNJ54HC151FK	SNJ54HC151FK

†包装图纸, 标准包装数里, 热数据, 符号和PCB设计指南
请访问www.ti.com/sc/package.



请注意, 有关可用性, 标准保修和重要应用的重要通知
德州仪器半导体产品和免责声明出现在本数据表的末尾。

生产数据信息截至发布日期为止。
德州仪器产品的条款和条件
标准生产加工不一定包括
测试所有参数。

TEXAS
INSTRUMENTS

邮政信箱 655303 • 达拉斯, 得克萨斯州 75265

版权 2003, 德州仪器公司
德州仪器公司的产品上, 所有参数都经过测试
除非另有说明, 在所有其他产品, 生产
处理不一定包括所有参数的测试。

SN54HC151, SN74HC151
8线数据选择器/多路复用器

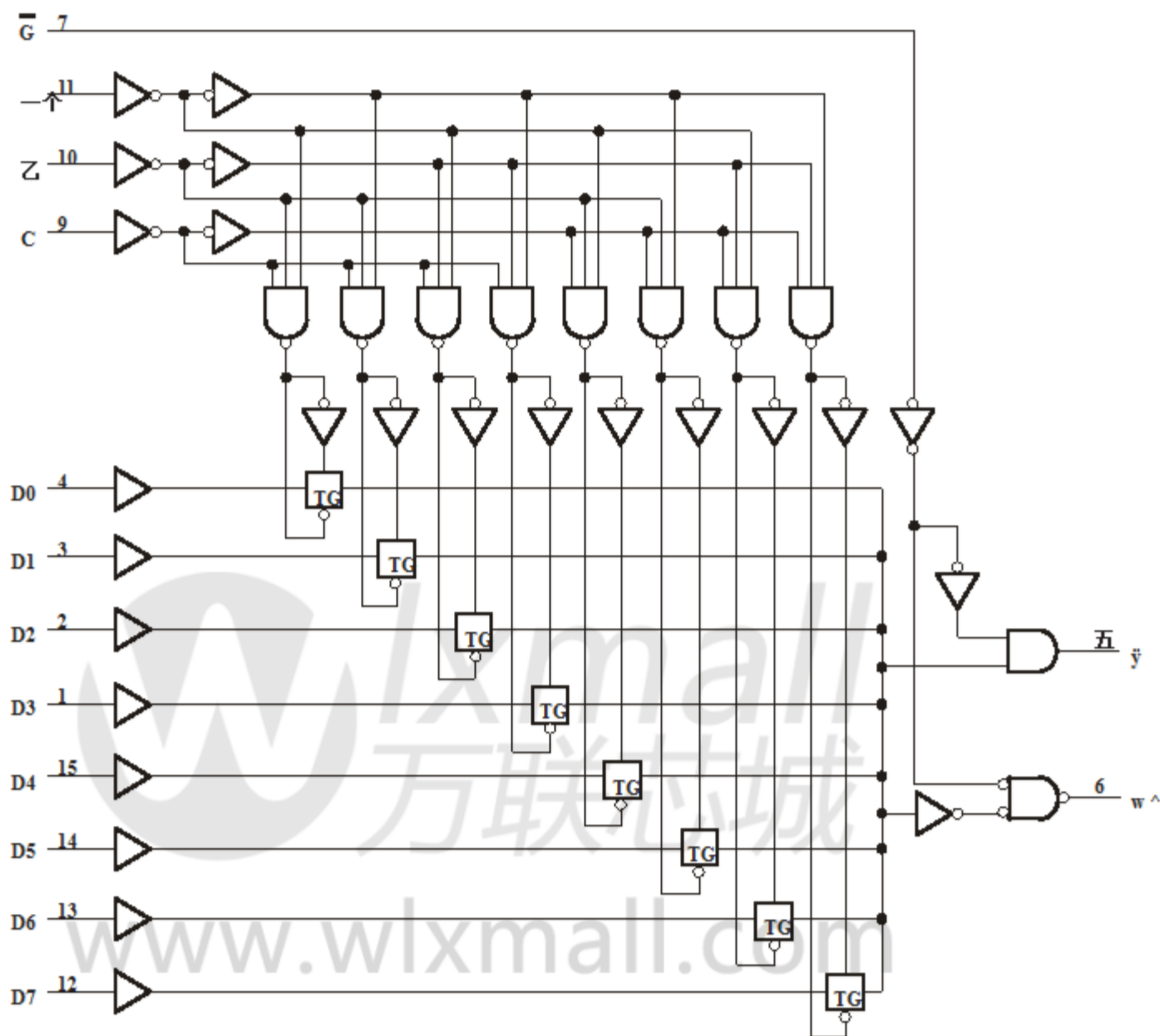
SCL S110E, 1982年12月, 修订2003年9月

功能表				
INPUTS			产出	
选择			频闪	G
C	乙	一个		
X	X	X	H	大号
大号	二		大号	D0
大号	LH		大号	D1
大号	HL		大号	D2
大号	HH		大号	D3
H	二		大号	D4
H	LH		大号	D5
H	HL		大号	D6
H	H	H	大号	D7

D0, D1... D7 =各个D输入的电平



逻辑图 (正逻辑)



所示的引脚编号为D, J, N, NS, PW和W封装.

SN54HC151, SN74HC151
8线数据选择器/多路复用器

SCL S110E, 1982年12月, 修订2003年9月

绝对最大额定值在运行自由空气温度范围（除非另有说明）†

电源电压范围, V_{CC}		-0.5V至7V
输入钳位电流 I_{IK} ($V_I < 0$ 或 $V_I > V_{CC}$) (见注1)		± 20 mA
输出钳位电流 I_{OK} ($V_O < 0$ 或 $V_O > V_{CC}$) (见注1)		± 20 mA
连续输出电流, I_O ($V_O = 0$ 至 V_{CC})		± 35 mA
持续电流通过 V_{CC} 或GND		± 70 mA
封装热阻抗,	θ_{JA} (见注2): D包	73 °C / W
	N包	67 °C / W
	NS包	64 °C / W
	PW包	108 °C / W
存储温度范围, T_{stg}		-65 °C至150°C

†强调超出“绝对最大额定值”列出的可能会导致设备永久性损坏.这些只是压力评级, 和在这些或任何其他超出“推荐的工作条件”下所述条件的条件下, 器件的功能操作不是默示.暴露在绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性.
笔记: 1.如果观察输入和输出电流额定值, 可能会超出输入和输出电压额定值.
2.封装热阻根据JESD 51-7计算.

推荐的操作条件（见注3）

		SN54HC151			SN74HC151			单元
		MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
VCC	电源电压	2	五	6	2	五	6	V
VIH	高电平输入电压	VCC = 2V			1.5			V
		VCC = 4.5V			3.15			
		VCC = 6 V			4.2			
VIL	低电平输入电压	VCC = 2V			0.5			V
		VCC = 4.5V			1.35			
		VCC = 6 V			1.8			
VI	输入电压	0	VCC		0	VCC		V
VO	输出电压	0	VCC		0	VCC		V
ΔT/ΔV	输入转换上升/下降时间	VCC = 2V			1000			NS
		VCC = 4.5V			500			
		VCC = 6 V			400			
TA	操作自由空气温度	-55	125		-40	85		C

注3: 器件的所有未使用输入必须保持在 V_{CC} 或GND, 以确保器件正常工作.请参阅TI应用报告, 慢速或浮动CMOS输入的含义, 文献编号SCBA004.

电气特性超过推荐的自由空气温度范围（除非另有说明）
另有说明）

参数	测试条件		V C C	TA = 25°C			SN54HC151		SN74HC151		单元
				MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
VOH	VI = VIH或VIL	IOH = -20μA	2 V	1.9	1.998		1.9		1.9		V
			4.5 V	4.4	4.499		4.4		4.4		
			6 V	5.9	5.999		5.9		5.9		
		IOH = -6mA	4.5 V	3.98	4.3		3.7		3.84		
		IOH = -7.8mA	6 V	5.48	5.8		5.2		5.34		
VOL	VI = VIH或VIL	IOL = 20μA	2 V		0.002	0.1		0.1		0.1	V
			4.5 V		0.001	0.1		0.1		0.1	
			6 V		0.001	0.1		0.1		0.1	
		IOL = 6毫安	4.5 V		0.17	0.26		0.4		0.33	
		IOL = 7.8 mA	6 V		0.15	0.26		0.4		0.33	
II	VI = VCC或0		6 V		±0.1	±100		±1000		±1000	nA的
ICC	VI = VCC或0, IO = 0		6 V			8		160		80	μA
词			2 V至6 V		3	10		10		10	pF的

在推荐工作自由空气温度范围内的开关特性 CL = 50 pF
（除非另有说明）（见图1）

参数	从 (INPUT)	至 (OUTPUT)	V C C	TA = 25°C			SN54HC151		SN74HC151		单元
				MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
TPD	A, B或C	Y或W	2 V		94	250		360		312	NS
			4.5 V		三十	50		73		63	
			6 V		25	43		62		54	
	任何D	Y或W	2 V		74	195		283		244	
			4.5 V		23	39		57		49	
			6 V		20	33		48		41	
	$\overline{G}$	Y或W	2 V		49	127		185		159	
			4.5 V		15	25		37		32	
			6 V		13	22		32		28	
TT		Y或W	2 V		22	75		110		95	NS
			4.5 V		9	15		22		19	
			6 V		8	13		19		16	

参数	从 (INPUT)	至 (OUTPUT)	V C C	TA = 25°C			SN54HC151		SN74HC151		单元
				MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
TPD	A, B或C	Y或W	2 V		107	350		525		440	NS
			4.5 V		33	70		105		88	
			6 V		二十	59		89		76	
	任何 D	Y或W	2 V		90	275		415		345	
			4.5 V		29	51		83		69	
			6 V		25	47		72		59	
	$\overline{\text{G}}$	Y或W	2 V		67	205		310		255	
			4.5 V		21	41		62		51	
			6 V		18	35		53		43	
TT		Y或W	2 V		51	210		315		265	NS
			4.5 V		16	42		63		53	
			6 V		14	36		53		45	

参数	测试条件	TYP	单元
C _{PD} 功耗电容	空载	70	pF的

注意: A. CL包括探头和测试夹具电容。
B. 波形之间的相位关系是任意选择的。所有输入脉冲由具有以下的发生器提供
特点: PR $\leq 1\text{MHz}$, ZO = 50 Ω , tr = 6ns, tf = 6ns。
C. 一次测量一个输出, 每次测量输入一次转换。
D. tPLH和tPHL与tpd相同。

图1.负载电路和电压波形

包装信息

可订购设备

状态
(1)

包装类型 包装

引脚包

数量

生态计划
(2)铅/球完成
(6)MSL峰值温度
(3)

操作温度 (°C)

设备标记
(4/5)

样品

84128012A

活性

LCCC

FK

20

1

TBD

POST-PLATE

N / A为Pkg类型

-55到125

84128012A
SNJ54HC
151FK

8412801EA

活性

CDIP

j

16

1

TBD

A42

N / A为Pkg类型

-55到125

8412801EA
SNJ54HC151J

SN54HC151J

活性

CDIP

j

16

1

TBD

A42

N / A为Pkg类型

-55到125

SN54HC151J

SN74HC151D

活性

SOIC

d

16

40

绿色 (RoHS
& 没有Sb / Br)

CU NIPDAU

等级-1-260C-UNLIM

-40至85

HC151

SN74HC151DE4

活性

SOIC

d

16

40

绿色 (RoHS
& 没有Sb / Br)

CU NIPDAU

等级-1-260C-UNLIM

-40至85

HC151

SN74HC151DG4

活性

SOIC

d

16

40

绿色 (RoHS
& 没有Sb / Br)

CU NIPDAU

等级-1-260C-UNLIM

-40至85

HC151

SN74HC151DR

活性

SOIC

d

16

2500

绿色 (RoHS
& 没有Sb / Br)

CU NIPDAU

等级-1-260C-UNLIM

-40至85

HC151

SN74HC151DRG4

活性

SOIC

d

16

2500

绿色 (RoHS
& 没有Sb / Br)

CU NIPDAU

等级-1-260C-UNLIM

-40至85

HC151

SN74HC151DT

活性

SOIC

d

16

250

绿色 (RoHS
& 没有Sb / Br)

CU NIPDAU

等级-1-260C-UNLIM

-40至85

HC151

SN74HC151N

活性

PDIP

n

16

25

无铅
(RoHS) 的

CU NIPDAU

N / A为Pkg类型

-40至85

SN74HC151N

SN74HC151NSR

活性

所以

NS

16

2000

绿色 (RoHS
& 没有Sb / Br)

CU NIPDAU

等级-1-260C-UNLIM

-40至85

HC151

SN74HC151PW

活性

TSSOP

PW

16

90

绿色 (RoHS
& 没有Sb / Br)

CU NIPDAU

等级-1-260C-UNLIM

-40至85

HC151

SN74HC151PWG4

活性

TSSOP

PW

16

90

绿色 (RoHS
& 没有Sb / Br)

CU NIPDAU

等级-1-260C-UNLIM

-40至85

HC151

SN74HC151PWR

活性

TSSOP

PW

16

2000

绿色 (RoHS
& 没有Sb / Br)

CU NIPDAU

等级-1-260C-UNLIM

-40至85

HC151

SN74HC151PWT

活性

TSSOP

PW

16

250

绿色 (RoHS
& 没有Sb / Br)

CU NIPDAU

等级-1-260C-UNLIM

-40至85

HC151

SNJ54HC151FK

活性

LCCC

FK

20

1

TBD

POST-PLATE

N / A为Pkg类型

-55到125

84128012A
SNJ54HC
151FK

可订购设备	状态 (1)	包装类型	包装 画画	引脚包 数量	生态计划 (2)	铅/球完成 (6)	MSL峰值温度 (3)	操作温度 (°C)	设备标记 (4/5)	样品
SNJ54HC151J	活性	CDIP	j	16	1	TBD	A42	N / A为Pkg类型	-55到125	8412801EA SNJ54HC151J

(1) 营销状况值定义如下:

ACTIVE: 推荐用于新设计的产品设备。

LIFEBUY: TI已经宣布该设备将停产, 终身购买期限已经生效。

NRND: 不建议用于新设计, 器件已投入生产以支持现有客户, 但TI不建议在新设计中使用此器件。

预览: 设备已被宣布, 但尚未投入生产, 样品或提供或不提供。

停产: TI已停止生产该设备。

(2) 环保计划 - 计划的环保分类: 无铅 (RoHS), 无铅 (RoHS豁免) 或绿色 (RoHS及无镉) - 请查询<http://www.ti.com/productcontent>获取最新的可用性信息和附加的产品内容细节。

待定: 无铅/绿色转换计划尚未定义。

无铅 (RoHS): TI的“无铅”或“无铅”术语表示所有6种物质都符合当前RoHS要求的半导体产品, 包括

铅在均质材料中不超过0.1重量%。在设计用于高温焊接的场合, TI无铅产品适用于特定的无铅工艺。

无铅 (RoHS豁免): 该组件对于1) 芯片和封装之间使用的基于引脚的倒装芯片焊料凸点, 或者2) 在以下之间使用的铅基芯片粘合剂具有RoHS豁免模具和引线框。该组件被视为无铅 (RoHS兼容), 如上所述。

绿色 (RoHS& no Sb / Br): TI定义“绿色”表示无铅 (RoHS兼容), 无溴 (Br) 和镉 (Cd) 基阻燃剂 (Br或Cd不超过0.1%重量在均质材料中)。

(3) MSL, Peak Temp. - 根据JEDEC行业标准分类的湿度敏感度等级等级, 以及峰值焊接温度。

(4) 可能会有额外的标记, 涉及设备上的徽标, 批次代码信息或环境类别。

(5) 多个设备标记将在括号内, 设备上只会显示一个包含在圆括号内的设备标记, 并以“~”分隔。如果一行缩进, 那么它是一个延续的前一行, 这两个组合代表该设备的整个设备标记。

(6) 铅/球完成 - 可订购设备可能有多个材料完成选项。完成选项由垂直格线分隔。铅/球完成值可能会包装到两行, 如果完成值超过了最大列宽。

重要信息和免责声明: 本页提供的信息代表TI在提供日期的知识和信念。TI基于其信息的知识和信念由第三方提供, 对此类信息的准确性不作任何陈述或保证。正在努力更好地整合来自第三方的信息。TI采取和继续采取合理步骤提供有代表性和准确的信息, 但可能没有对来料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI和TI供应商认为某些信息是专有的, 因此CAS号和其他有限的信息可能无法发布。

在任何情况下, TI因此类信息所产生的责任均不得超过TI每年向客户出售本文件中涉及的TI部分的总购买价格。

SN54HC151, SN74HC151的其他合格版本:

www.ti.com

10月-2014

- 目录: SN74HC151
- 汽车: SN74HC151-Q1, SN74HC151-Q1
- 军事: SN54HC151

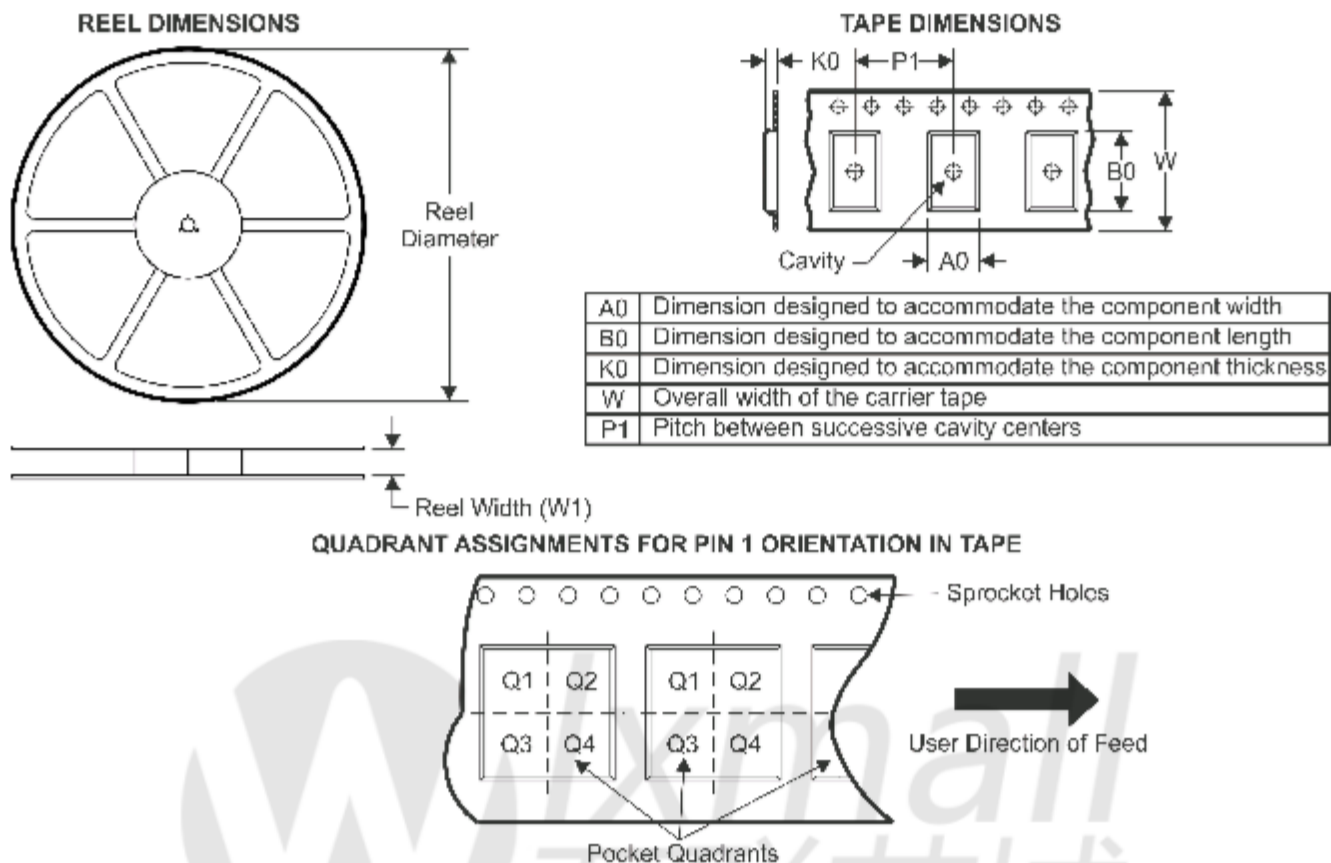
注: 限定版本定义:

- 目录 - TI的标准目录产品
- 汽车 - 适用于针对零缺陷的高可靠性汽车应用的Q100器件
- 军事 - 获得军事和国防应用的QML认证



lxmall
万联芯城
www.wlxmall.com

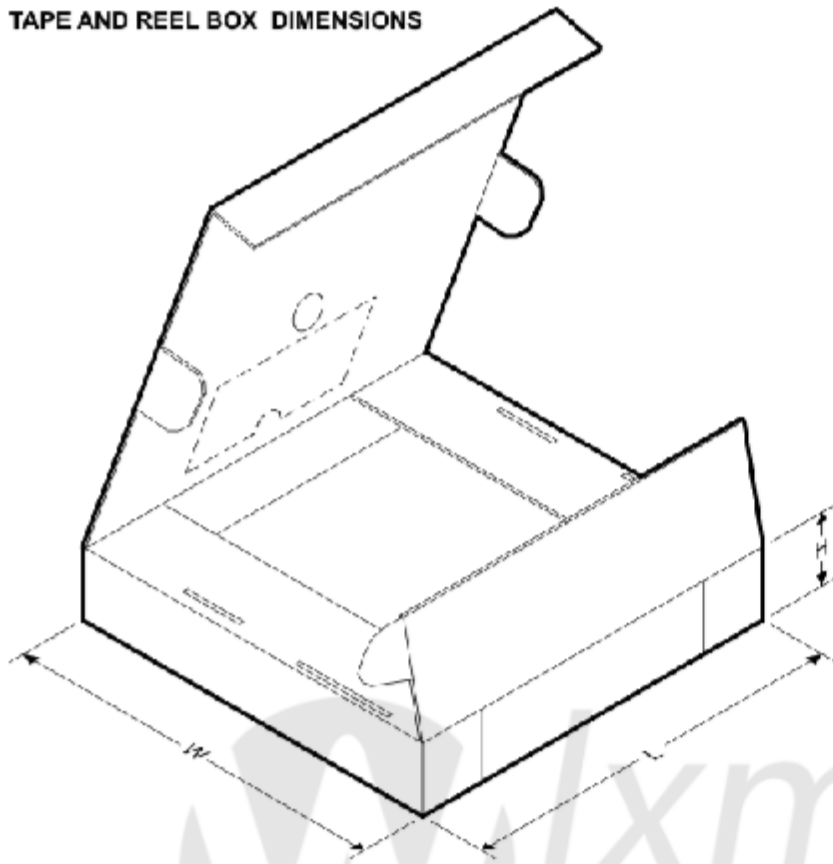
胶带和卷轴信息



*所有尺寸都是标称的

设备	包 类型	包 画	销	SPQ	卷轴 直径 (毫米)	卷轴 宽度 (毫米)	A0 (毫米)	B0 (毫米)	K0 (毫米)	P1 (毫米)	w ^ (毫米)	PIN1 象限
SN74HC151DR	SOIC	d	16	2500	330.0	16.4	6.5	10.3	2.1	8	16.0	Q1
SN74HC151PWR	TSSOP	PW	16	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8	12.0	Q1
SN74HC151PWT	TSSOP	PW	16	250	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



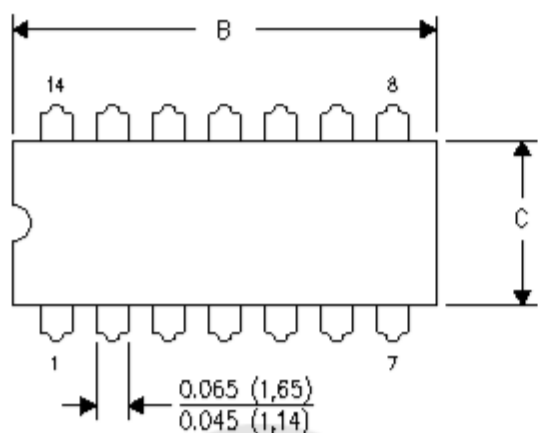
*所有尺寸都是标称的

设备	包装类型	包装图纸	销	SPQ	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
SN74HC151DR	SOIC	d	16	2500	333.2	345.9	28.6
SN74HC151PWR	TSSOP	PW	16	2000	367.0	367.0	35.0
SN74HC151PWT	TSSOP	PW	16	250	367.0	367.0	35.0

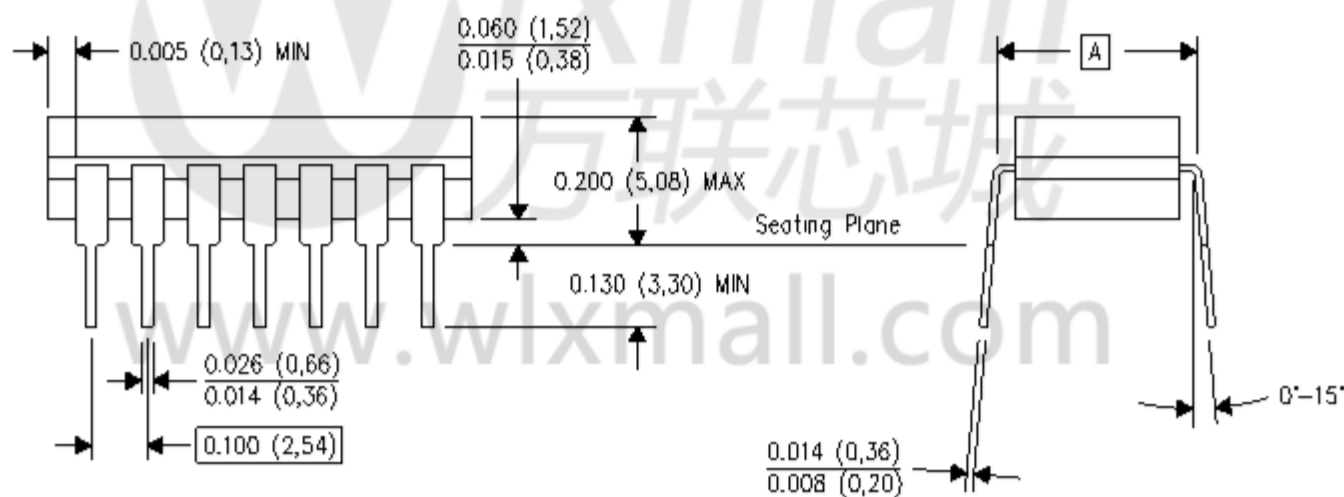
J (R-GDIP-T**)

14 LEADS SHOWN

CERAMIC DUAL IN-LINE PACKAGE



DIM \ PINS **	14	16	18	20
A	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC
B MAX	0.785 (19,94)	.840 (21,34)	0.960 (24,38)	1.060 (26,92)
B MIN	—	—	—	—
C MAX	0.300 (7,62)	0.300 (7,62)	0.310 (7,87)	0.300 (7,62)
C MIN	0.245 (6,22)	0.245 (6,22)	0.220 (5,59)	0.245 (6,22)



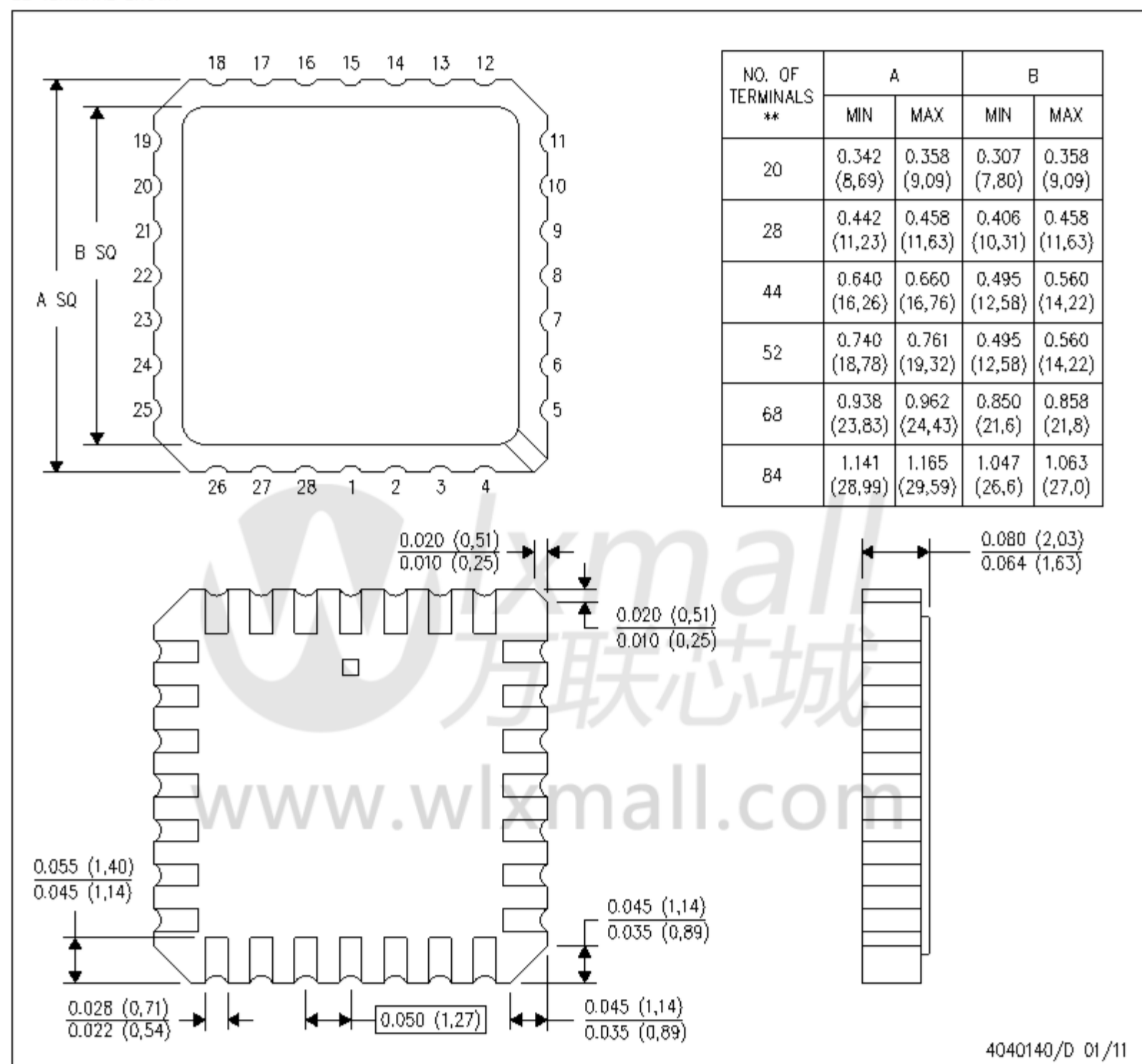
4040083/F 03/03

- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. This package is hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
 - D. Index point is provided on cap for terminal identification only on press ceramic glass frit seal only.
 - E. Falls within MIL STD 1835 GDIP1-T14, GDIP1-T16, GDIP1-T18 and GDIP1-T20.

FK (S-CQCC-N**)

28 TERMINAL SHOWN

LEADLESS CERAMIC CHIP CARRIER

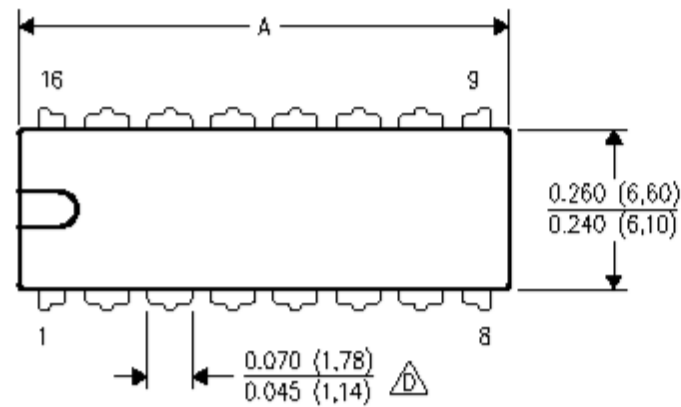


- NOTES:
- All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - This drawing is subject to change without notice.
 - This package can be hermetically sealed with a metal lid.
 - Falls within JEDEC MS-004

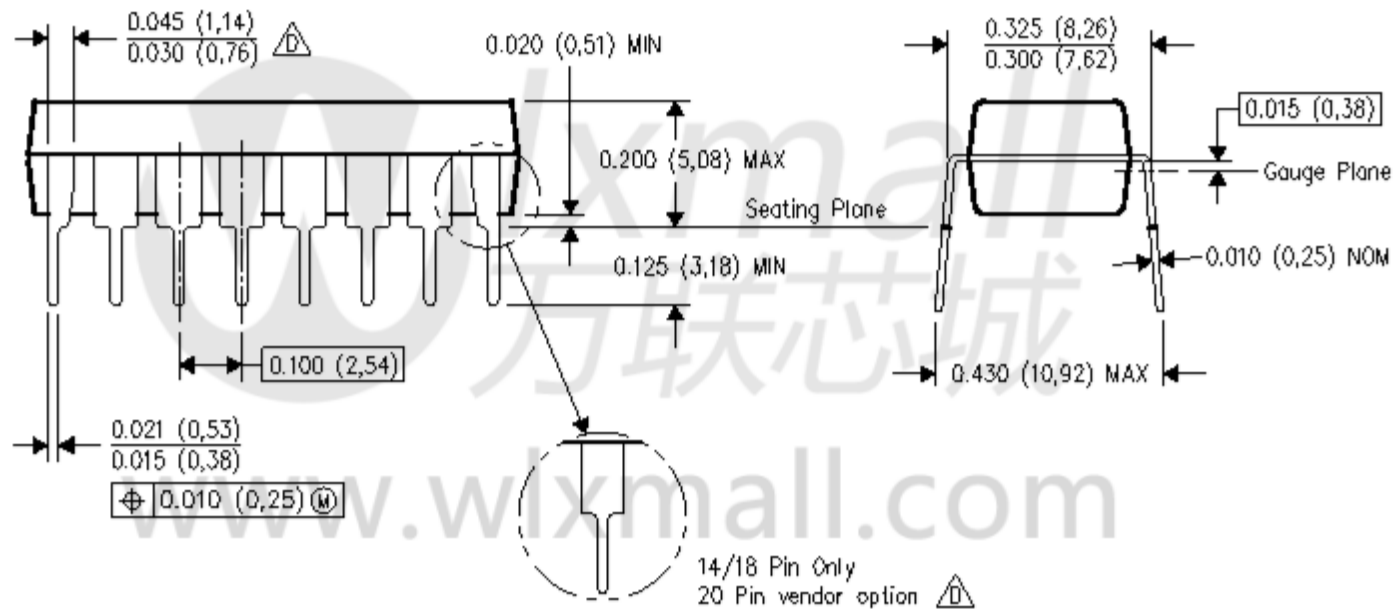
N (R-PDIP-T**)

16 PINS SHOWN

PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE



DIM \ PINS **	14	16	18	20
A MAX	0.775 (19,69)	0.775 (19,69)	0.920 (23,37)	1.060 (26,92)
A MIN	0.745 (18,92)	0.745 (18,92)	0.850 (21,59)	0.940 (23,88)
MS-001 VARIATION	AA	BB	AC	AD

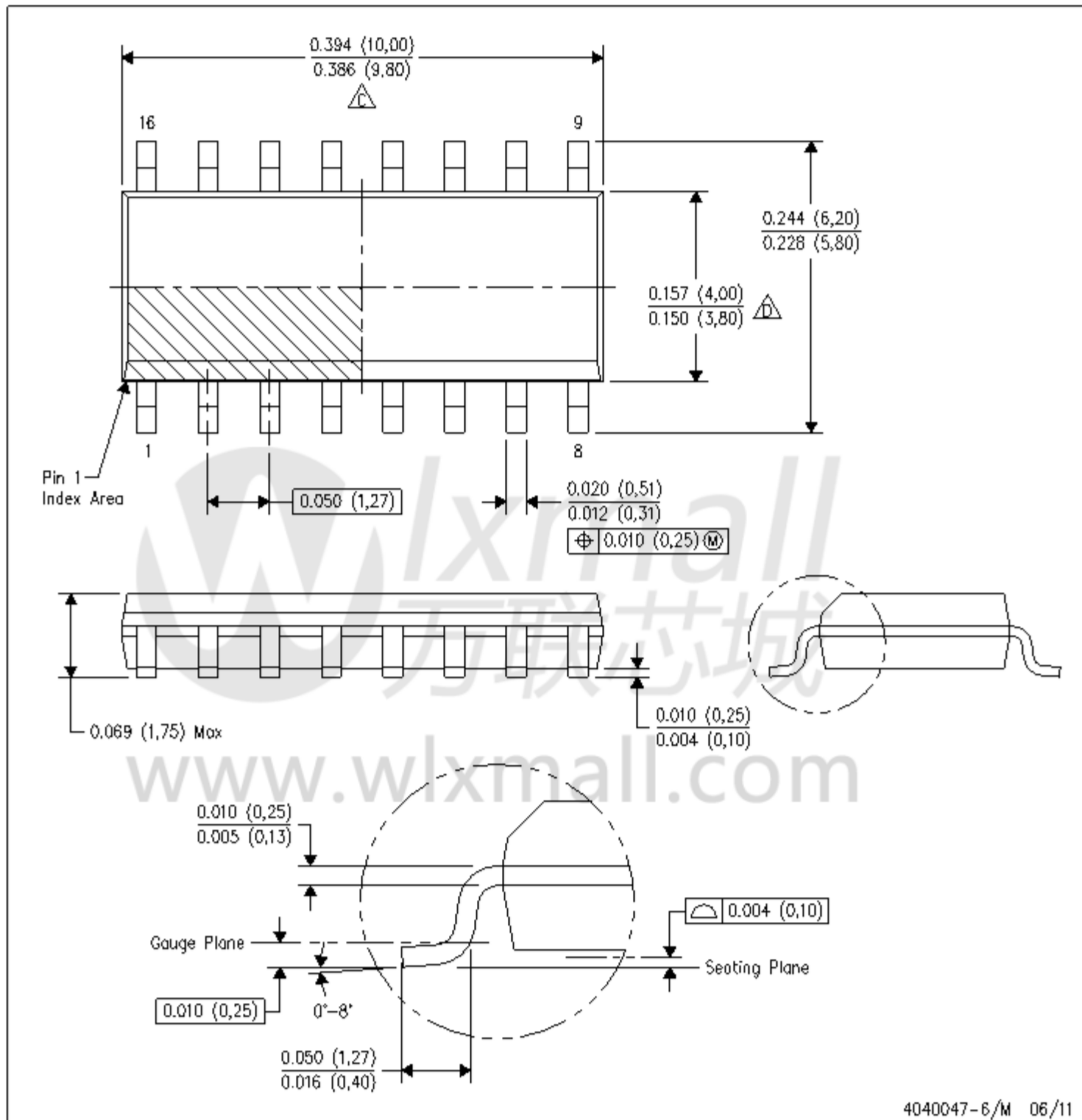


4040049/E 12/2002

- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - $\triangle$ Falls within JEDEC MS-001, except 18 and 20 pin minimum body length (Dim A).
 - $\triangle$ The 20 pin end lead shoulder width is a vendor option, either half or full width.

D (R-PDSO-G16)

PLASTIC SMALL OUTLINE

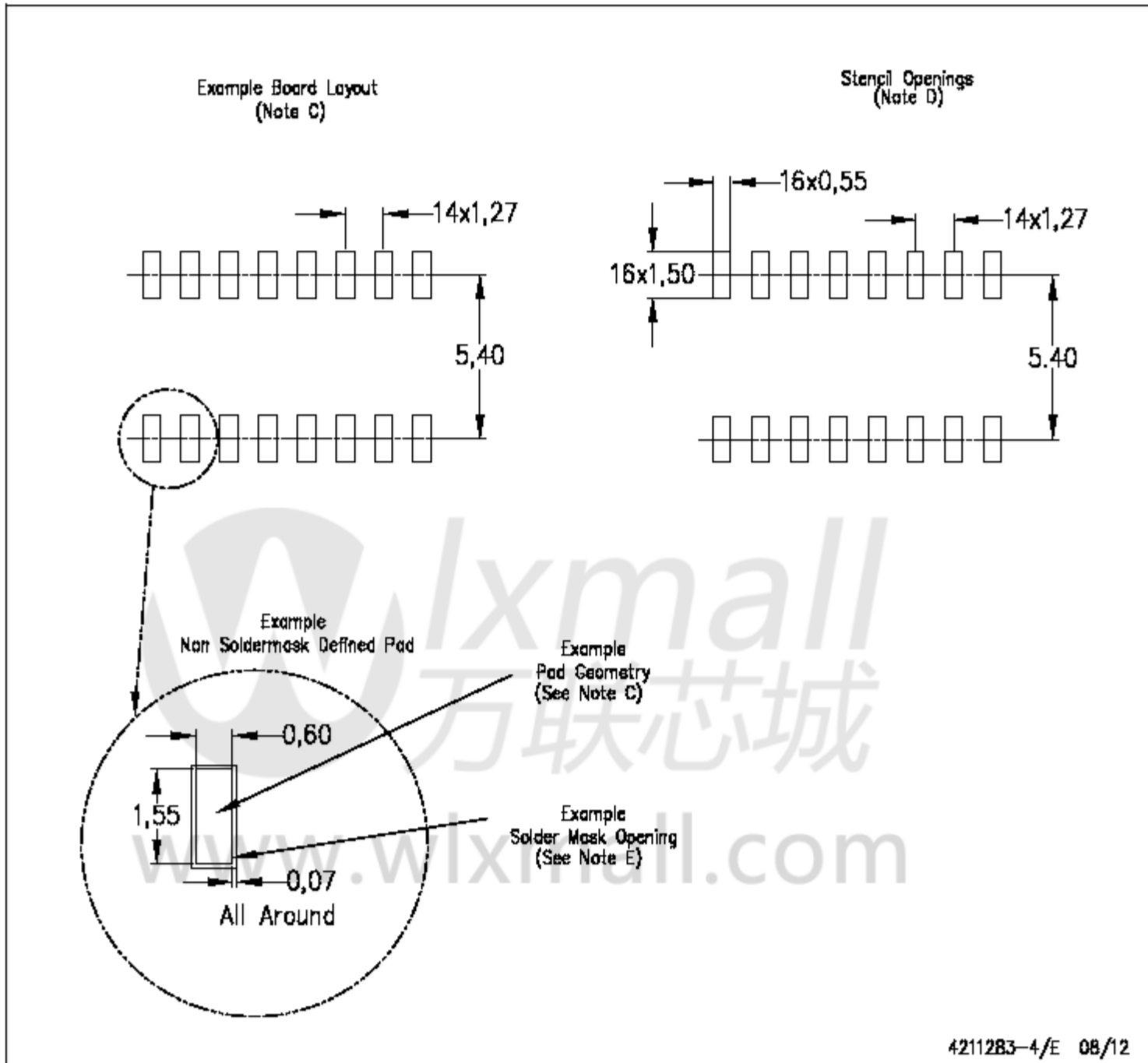


NOTES:

- All linear dimensions are in inches (millimeters).
- This drawing is subject to change without notice.
- Body length does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.006 (0,15) each side.
- Body width does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.017 (0,43) each side.
- Reference JEDEC MS-012 variation AC.

D (R-PDSO-G16)

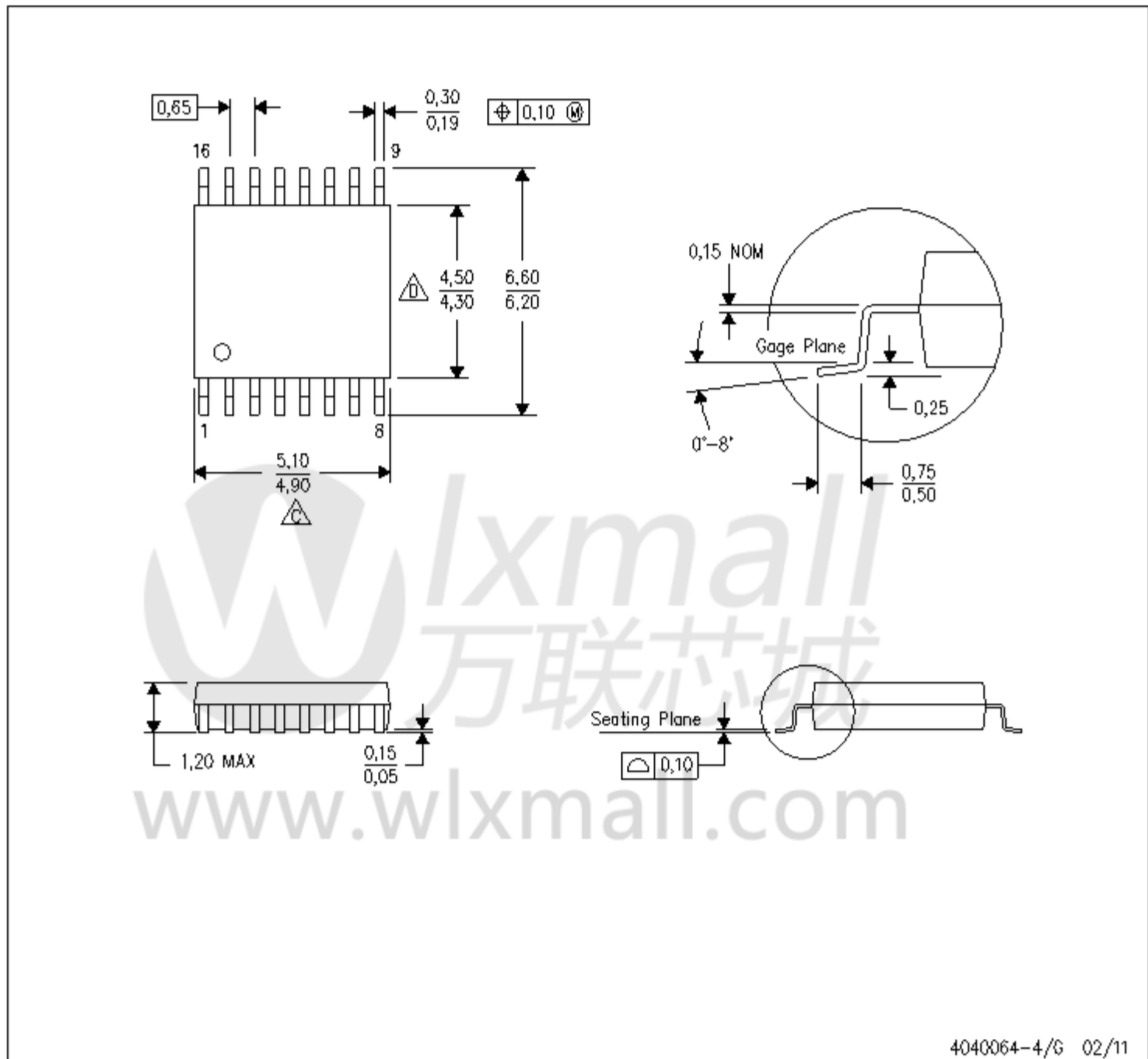
PLASTIC SMALL OUTLINE



- NOTES:
- All linear dimensions are in millimeters.
 - This drawing is subject to change without notice.
 - Publication IPC-7351 is recommended for alternate designs.
 - Laser cutting apertures with trapezoidal walls and also rounding corners will offer better paste release. Customers should contact their board assembly site for stencil design recommendations. Refer to IPC-7525 for other stencil recommendations.
 - Customers should contact their board fabrication site for solder mask tolerances between and around signal pads.

PW (R-PDSO-G16)

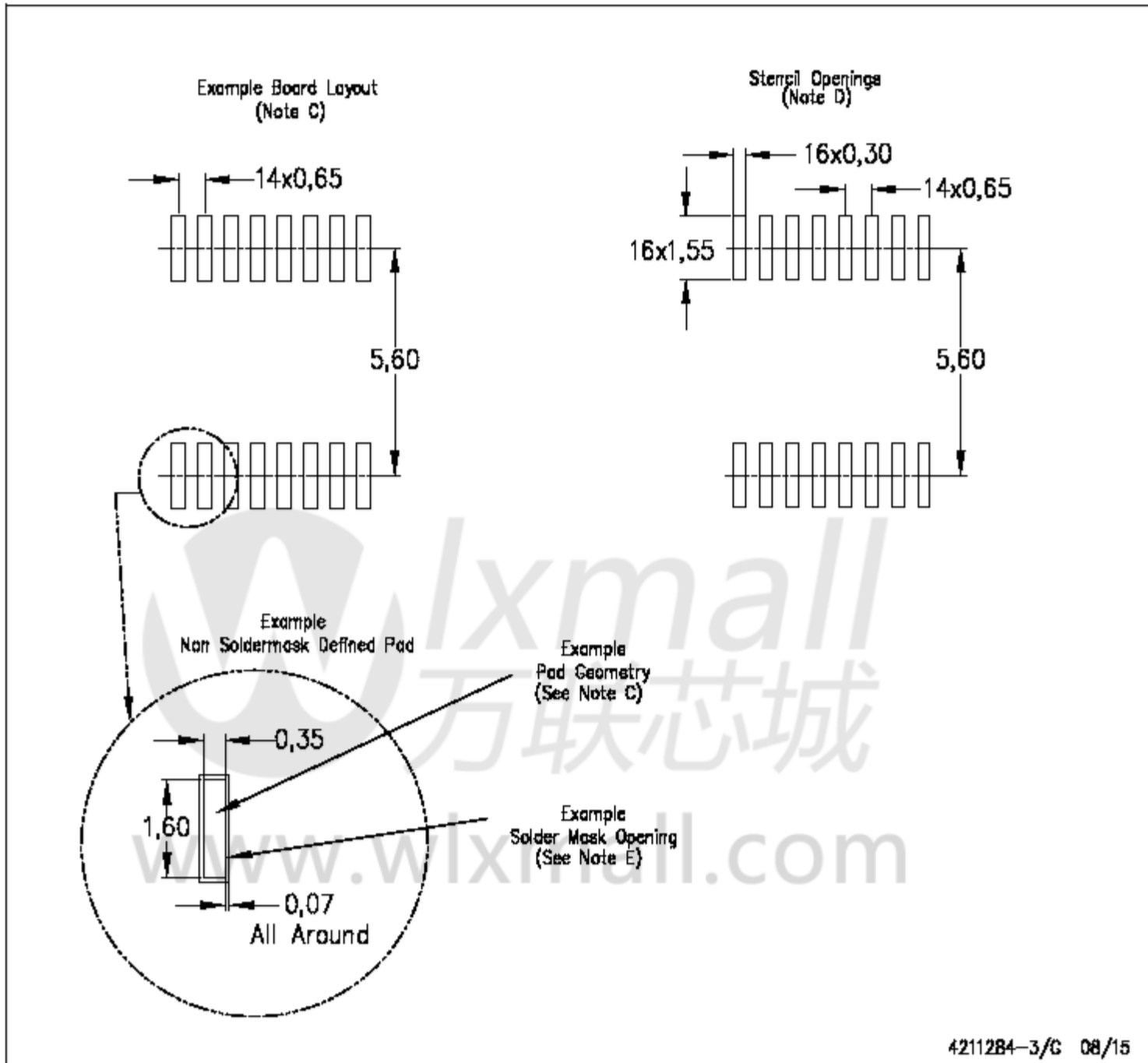
PLASTIC SMALL OUTLINE



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - $\triangle$ C. Body length does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0,15 each side.
 - $\triangle$ D. Body width does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0,25 each side.
 - E. Falls within JEDEC MO-153

PW (R-PDSO-G16)

PLASTIC SMALL OUTLINE



NOTES:

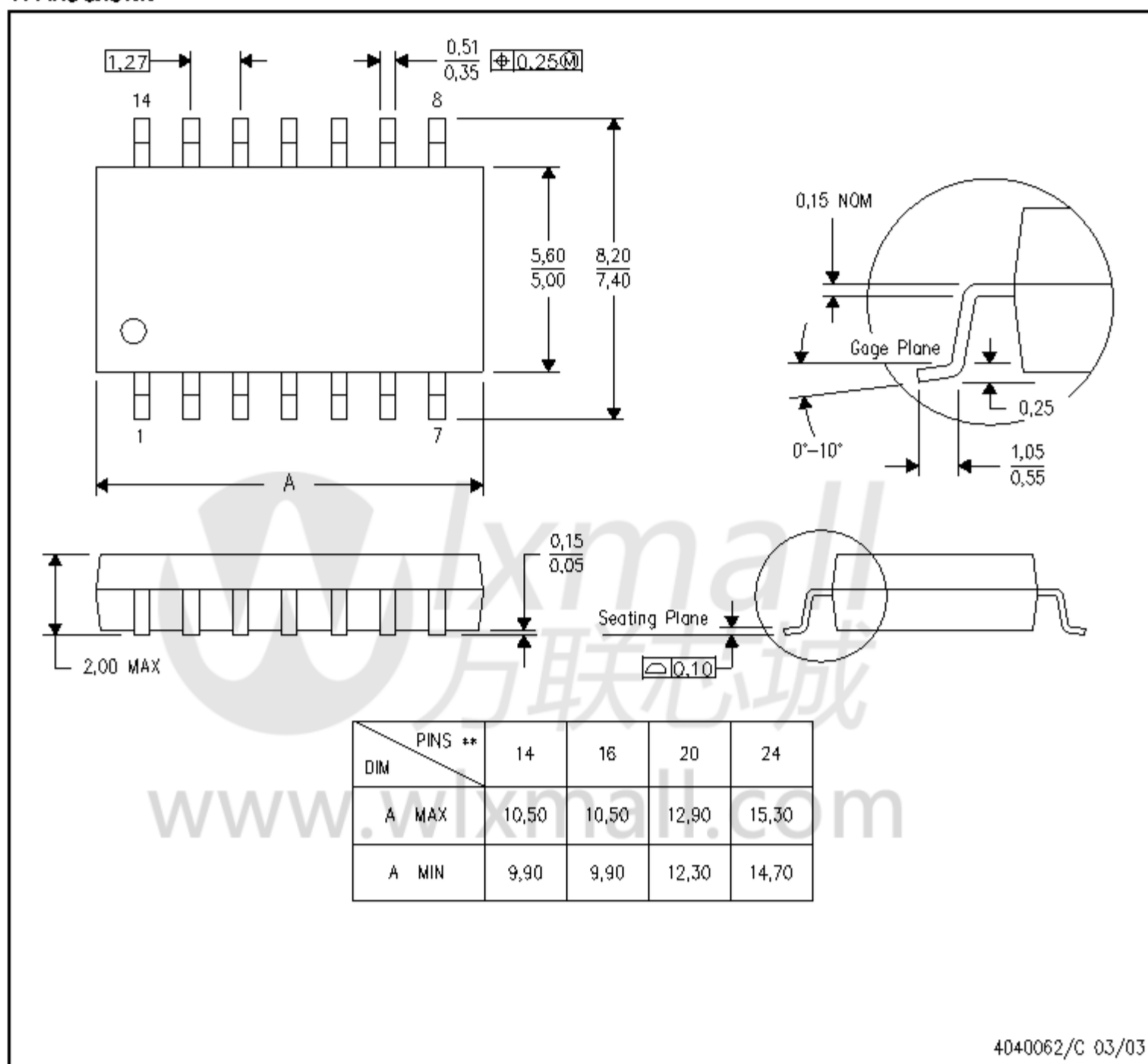
- All linear dimensions are in millimeters.
- This drawing is subject to change without notice.
- Publication IPC-7351 is recommended for alternate designs.
- Laser cutting apertures with trapezoidal walls and also rounding corners will offer better paste release. Customers should contact their board assembly site for stencil design recommendations. Refer to IPC-7525 for other stencil recommendations.
- Customers should contact their board fabrication site for solder mask tolerances between and around signal pads.

MECHANICAL DATA

NS (R-PDSO-G**)

PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE

14-PINS SHOWN



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15.

重要的提醒

德州仪器 (TI) 及其子公司 (TI) 保留更正, 增强, 改进等方面的权利。根据最新的 JESD46 更改其半导体产品和服务, 并根据 JESD48 停止提供任何产品或服务问题。买家在下订单之前应该获得最新的相关信息, 并且应该确认这些信息是最新的完成。所有半导体产品 (在本文中也称为“组件”) 均根据 TI 的销售条款和条件进行销售在订单确认时提供。

根据 TI 条款的保证, TI 保证其组件的性能符合销售时适用的规格和半导体产品的销售条件。在 TI 认为必要的范围内使用测试和其他质量控制技术以支持此保修。除适用法律规定的情况外, 每个组件的所有参数的测试不一定是必需的执行。

TI 不承担应用协助或买方产品设计的责任。买家负责他们的产品和使用 TI 组件的应用。为了尽量减少与买家的产品和应用相关的风险, 买家应该提供适当的设计和操作保障。

德州仪器不保证或表示任何明示或暗示的许可是根据任何专利权, 版权, 掩盖作品权或或使用 TI 组件或服务的任何组合, 机器或流程有关的其他知识产权。信息由 TI 发布的关于第三方产品或服务的许可不构成使用此类产品或服务或保修的许可。使用此类信息可能需要第三方根据专利或其他知识产权的许可。TI 的专利或其他知识产权的第三方或 TI 许可。

在 TI 数据手册或数据手册中复制 TI 信息的重要部分, 只有在没有改动的情况下才允许使用并附有所有相关的担保, 条件, 限制和通知。对于此类改变, TI 不承担任何责任。文档。第三方信息可能会受到额外的限制。

TI 组件或服务的转售, 其声明不同于或超出 TI 针对该组件或服务规定的参数。对相关的 TI 组件或服务均无任何明示或暗示的担保, 是不公平和欺骗性的商业行为。TI 对此类声明不承担任何责任。

买方承认并同意全权负责遵守所有与法律, 法规和安全相关的要求关于其产品, 以及在使用中使用 TI 组件, 尽管有任何与应用相关的信息或支持。这可能由 TI 提供。买方代表并同意其拥有所有必要的专业知识来制定和实施保障措施。预测故障的危险后果, 监视故障及其后果, 减少可能导致故障的可能性。伤害并采取适当的补救措施。买方将全额赔偿 TI 及其代表对由此引起的任何损害在安全关键应用中的任何 TI 组件。

在某些情况下, 可能会特别推广 TI 组件, 以促进安全相关的应用。有了这样的组件, TI 的目标是帮助客户设计和创建自己的终端产品解决方案, 以满足适用的功能安全标准要求。尽管如此, 这些组件也受这些条款的约束。

除非当事方的授权人员, 否则没有 TI 组件被授权在 FDA III 级 (或类似的生命关键的医疗设备) 中使用已经执行了特别的协议来管理这种使用。

只有 TI 特别指定为军用等级或“增强塑料”的 TI 组件才被设计和使用。军事/航空应用或环境。买方承认并同意任何军事或航空航天使用 TI 组件。如果没有被指定, 则由买方承担全部责任, 买方应全权负责遵守所有法律和法规与这种使用有关的监管要求。

TI 特别指定某些组件符合 ISO / TS16949 要求, 主要用于汽车用途。在任何情况下使用非指定产品, TI 将不会对任何不符合 ISO / TS16949 的产品负责。

制品

音频	www.ti.com/audio
放大器	amplifier.ti.com
数据转换器	dataconverter.ti.com
DLP® 产品	www.dlp.com
DSP	dsp.ti.com
时钟和定时器	www.ti.com/clocks
接口	interface.ti.com
逻辑	logic.ti.com
电源管理	power.ti.com
微控制器	microcontroller.ti.com
RFID	www.ti-rfid.com
OMAP 应用程序处理器	www.ti.com/omap
无线连接	www.ti.com/wirelessconnectivity

应用

汽车和运输	www.ti.com/automotive
通信和电信	www.ti.com/communications
计算机和外围设备	www.ti.com/computers
消费类电子产品	www.ti.com/consumer-apps
能源和照明	www.ti.com/energy
产业	www.ti.com/industrial
医	www.ti.com/medical
安全	www.ti.com/security
空间, 航空电子和国防	www.ti.com/space-avionics-defense
视频和影像	www.ti.com/video

TI E2E 社区

e2e.ti.com